



Leica EM MP

操作手册

订购号: 192131

Leica EM MP-GA-D/E-03/03



带3种不同温度的Leica EM MP多功能热盘，用于：

- ☐ 将槽安装到玻璃刀上。
- ☐ 烘干载玻片上的半薄切片
- ☐ 将半薄切片染色

安全注意事项

仪器的设计与制造确保在正确使用的情況下，不会对操作者产生任何危害。

使用仪器前，请认真阅读操作手册。

仪器只能由授权的服务人员拆卸。

拆卸仪器前，必须先断开主电源。

仪器装有接地保护。在与本地电源连接前，确保主电源有所需接地，且仪器是按法规进行连接的。

安装或更换保险丝前，先将仪器的插头拔下。

受热面为高温区。

操作期间，受热面温度高于100°C 即212°F。

因此操作受热面时，只能使用操作说明中介绍的工具。
受热面会引起燃烧。接触这些部件会对安全造成危害。





1. 按下绿色按钮，开启多功能热盘。



2. 制作玻璃刀，准备所需的槽。



3. 将抹刀的尖端置于井内，左边或右边均可。



4. 将牙科蜡熔于熔化面板的框板面上。如果必要，可将井内的蜡添加到2/3。



5. 刀刃突出边沿，将刀置于烘干面板上2分钟左右，使其受热。



6. 要使用牙科蜡，可将槽置于熔化面板上使导边位于凹槽内。



7. 立即将槽安装到受热的刀上。向刀的左侧按下导边，其上缘应当与刀刃保持在同一水平。切勿触摸槽内以防污染。



8. 用井内的蜡密封槽的边缘。使用抹刀的尖端进行操作。



9. 现在准备切片。如果不立即进行切片，则将刀置于刀盒内避免污染。

将切片烘干并染色



1. 烘干面板上可放置6片切片。

烘干时间为1到2分钟，温度为80°C (176°F)



2. 染色时，安装升高面板，形成温度为60°C (140°F)的加热面板。

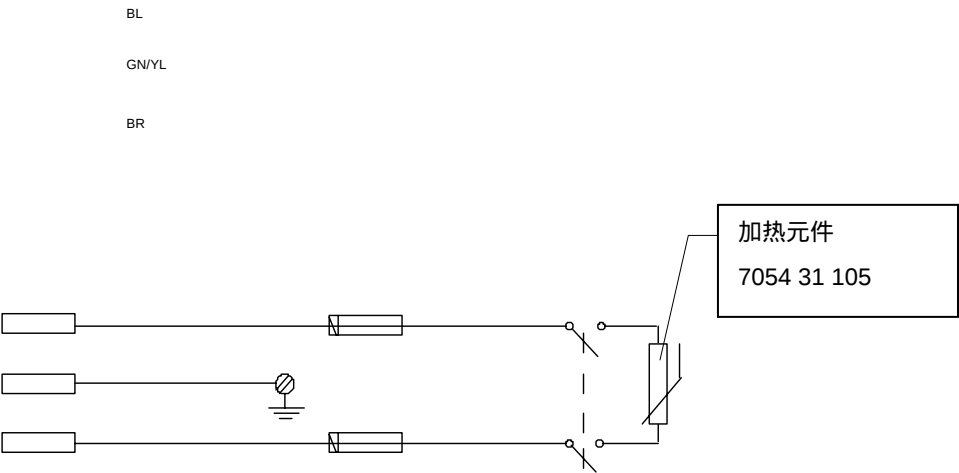
订购信息

槽	6.4mm	Cat.Nr.16 84 00 42
槽	8.0mm	Cat.Nr.16 84 00 45
槽	10.0mm	Cat.Nr.16 84 00 46

抹 刀		Cat.Nr.16 84 01 08
牙科蜡	500g	Cat.Nr.16 84 01 09
保险丝	2AT (10根)	Cat.Nr.16 86 01 65
保险丝	1AT (10根)	Cat.Nr.16 86 01 62

电气信息

V~	100 - 240	
Hz	50 - 60	
VA	400	
保险丝	100 - 120V	2AT



符合性申明

我 方	Leica Mikrosysteme GmbH Hernalser Hauptstrasse 219 A-1170 Wien Austria
-----	---

独立承担责任，申明该产品：

型 号	LEICA EM MP
-----	--------------------

类 别	70542
-----	--------------

：

与本申明相关联，符合下列标准：

EN 61010-1

EN 50081-1

EN 50082-1

EN 61000-4

遵从下列准则：

89 / 336 / EEC	(电磁兼容性)
----------------	---------

73 / 23 / EEC	(低电压设备)
---------------	---------

89 / 392 EEC	(机械)
--------------	------

Wien, 1990年12月30日

Dr. Reinhard Lihl
研发经理

Chef du service
développement

徕卡仪器有限公司(北京办事处及维修站)

北京首都体育馆南路 6 号
新世纪饭店办公楼 858 室
邮编:100044
电话:010-68492698
传真:010-68492965

徕卡仪器有限公司(上海办事处及维修站)

上海淮海中路 398 号
世纪巴士大厦 18 楼 C 室
邮编:200020
电话:(021)63876606
传真:(021)63876608

徕卡仪器有限公司(成都办事处及维修站)

成都人民南路四段 6 号
时代数码大厦 18 楼 B6 座
邮编: 610041
电话:028-86316606
传真:028-86316607

徕卡仪器有限公司(广州办事处及维修站)

广州先烈中路 76 号
中侨大厦 18 楼 H 室
邮编:510075
电话:020-87320225
传真:020-87321519

Leica Mikrosysteme GmbH
Hernalser Hauptstrasse 219
A-1170 Wien

电话 : +43 48899
传真 : +43 1 48899-350
www.em-preparation.com



Leica
MICROSYSTEMS